

AI チップ設計拠点フォーラム(第70回)開催案内【Web開催】

1. 日時 4月25日(金)13:30-16:00

2. 開催方法

Web フォーラム

(参加登録者には4月23日～4月25日午前中に Web フォーラム参加のためのリンクアドレスを通知いたします)

3. アジェンダ

13:30-13:35 「AI チップ設計拠点について」

(産総研/内山邦男)

13:35-14:20 「CES 2025 にみるエレクトロニクス技術動向」

(東京農工大学/丹羽 直也先生)

14:20-15:05 「ISSCC2025 における AI チップ研究動向」

(産総研/更田 裕司氏)

15:05-15:15 休憩

15:15-16:00 「先端半導体パッケージと ISSCC' 25 におけるチップレット技術の動向」

(日立製作所・産総研/植松 裕氏)